

Title (en)

Memory alloy based on Cu-Al or on Cu-Al-Ni and process for the stabilisation of the two-way effect.

Title (de)

Formgedächtnislegierung auf der Basis von Cu/Al oder Cu/Al/Ni und Verfahren zur Stabilisierung des Zweiwegeeffektes.

Title (fr)

Alliage à mémoire de forme à base de Cu-Al ou de Cu-Al-Ni et procédé pour la stabilisation de l'effet de réversibilité.

Publication

EP 0035069 A1 19810909 (DE)

Application

EP 80200183 A 19800303

Priority

EP 80200183 A 19800303

Abstract (en)

1. Memory alloy of the Cu/Al or Cu/Al/Ni type, characterised in that it is non-aging up to a temperature of 300 degrees C, consists predominantly of the beta-high temperature phase and shows a stable two-way effect in the temperature range from 100 to 250 degrees C.

Abstract (de)

Kupferreiche, den Zweiwegeeffekt zeigende Cu/Al- und Cu/Al/Ni-Gedächtnislegierungen werden dadurch stabilisiert und für den Temperaturbereich von 100 bis 250°C brauchbar gemacht, daß sie nach der letzten Glühung im β -Mischkristallgebiet und vor der Induzierung des Zweiwegeeffektes zusätzlich im Temperaturbereich von 200 bis 350°C während 0,5 bis 600 min zwischengeglüht werden. Die Zwischenglühung kann als Anlassen nach dem Abschrecken auf Raumtemperatur oder aber als Stufenabschreckung in ein Salzbad direkt aus dem β -Mischkristallgebiet auf die entsprechende Temperatur erfolgen.

IPC 1-7

C22F 1/08; **C22C 9/01**

IPC 8 full level

C22C 9/00 (2006.01); **C22C 9/01** (2006.01); **C22F 1/00** (2006.01); **C22F 1/08** (2006.01)

CPC (source: EP)

C22C 9/01 (2013.01); **C22F 1/006** (2013.01)

Citation (search report)

- GB 1346047 A 19740206 - FULMER RES INST LTD
- GB 433534 A 19350812 - THOMAS BOLTON AND SONS LTD, et al

Cited by

EP0086014A1; US4634477A; US4533411A; FR2643086A1; US5066341A; EP0382109A1; EP0297004A3; FR2617187A1; EP0209466A3; FR2590048A1; FR2618163A1; US4654092A

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0035069 A1 19810909; **EP 0035069 B1 19831221**; DE 3065930 D1 19840126; JP H0138867 B2 19890816; JP S56136945 A 19811026; PT 72590 A 19810301; PT 72590 B 19820212

DOCDB simple family (application)

EP 80200183 A 19800303; DE 3065930 T 19800303; JP 2850381 A 19810302; PT 7259081 A 19810227